

左右2方向を検出可能な本体厚1.5mmの薄型タイプ。



検出

スライド

フッシュ

ロータリ

電源

ディップタイプ

汎用タイプ

防水タイプ

■主な仕様



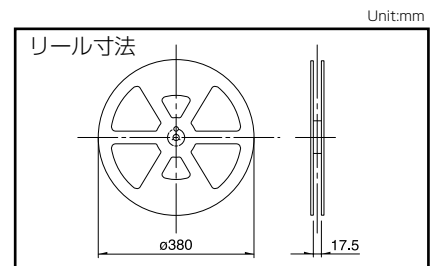
項目		仕様
最大定格/最小定格(抵抗負荷)		1mA 5V DC/50μA 3V DC
接触抵抗(初期/寿命後)		2Ω max./5Ω max.
作動力		0.35N max.
動作寿命	無負荷	50,000cycles
	負荷	50,000cycles(1mA 5V DC)

■製品一覧

回路数	接点数	全移動量 (mm)	端子形状	位置決めピン	最小発注単位 (pcs.)		製品番号
					国内	輸出	
1	2	1.57	For PC board (Reflow)	あり	3,000	12,000	SSCM110100
				なし			SSCM120100

■梱包仕様
テーピング

1 リール	梱包数 (pcs.)		テープ幅 (mm)	輸出梱装箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出		
3,000	6,000	12,000	16	417×409×139

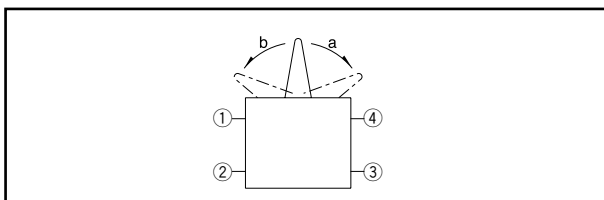


■外形図

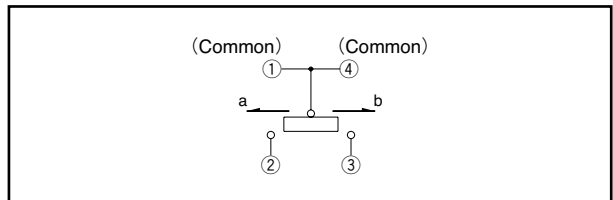
形状	プリント基板取付穴およびランド寸法図 (A方向より見る)
<p>With boss</p>	

注記 外形図は位置決めピンありタイプを示しています。

■端子配列 (A方向より見る)



■回路図



検出スイッチ

バラエティー一覧

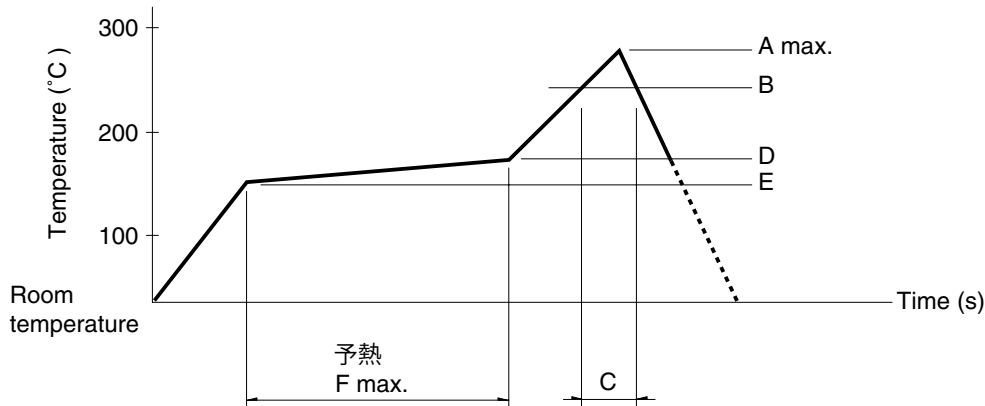
シリーズ		汎用タイプ				
		SPPW8	SSCQ	SSCM	SPVL	SPPB
写真						
動作形式		1方向	2方向 片側2段	2方向	3方向	1方向 2方向
外形サイズ (mm)	W	5	3.8	5	5.55	6.3
	D	4	3.6	4	6.6	3
	H		0.9	1.5	1	4.9
使用温度範囲		-10℃ ~ +60℃			-40℃ ~ +85℃	
車載対応製品		—	—	—	●	●
ライフサイクル						
回路数 / 接点数		1/1	1/左右方向 各2接点	1/2	1/1	
最大定格 (抵抗負荷)		0.1A 30V DC	1mA 5V DC			0.1A 30V DC
最小定格 (抵抗負荷)		100μA 3V DC	50μA 3V DC			
耐久性	無負荷寿命	100,000cycles 2Ω max.	50,000cycles 5Ω max.			50,000cycles 2Ω max.
	負荷寿命 最大定格 負荷にて	100,000cycles 2Ω max.	50,000cycles 5Ω max			50,000cycles 2Ω max.
電気的 性能	初期接触抵抗	1Ω max.	2Ω max.			1Ω max.
	絶縁抵抗	100MΩ min. 100V DC				
	耐電圧	100V AC for 1 minute				
機械的 性能	端子強度	3N for 1minute	0.5N for 1minute		1N for 1minute	3N for 1minute
	操作部強度	10N	1N	2N	5N	10N
耐候性	耐寒性	-20℃ 96h			-40℃ 500h	
	耐熱性	85℃ 96h			85℃ 500h	
	耐湿性	40℃, 90 ~ 95%RH 96h			60℃, 90 ~ 95%RH 500h	
作動力		0.3N max.	0.35N max.			
ページ		29	31	32	33	34

検出スイッチはんだ付条件 71
 検出スイッチご使用上の注意 72

注記 表中の●印は、シリーズ中の全ての製品が対応していることを表します。

リフロー方式の参考例

1. 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
2. 温度測定方式 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ のCA(K)またはCC(T)を用い測定。位置ははんだ接合部(銅箔面)で測定。固定方式は耐熱テープを使用する。
3. 温度プロファイル



シリーズ(リフロータイプ)	A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)				
SPPB	250	230	40	180	150	120				
SPPW8			35							
SPVE	260		40				40	180	150	120
SPVL										
SPVM										
SPVN										
SPVR										
SPVS										
SPVT										
SSCM										
SSCQ										
SPVQC	250									

注記

1. 上記条件は、プリント基板の部品実装面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度が大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内でご使用ください。
2. リフロー槽の種類により多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

手はんだ方式の参考例

シリーズ	はんだ温度	はんだ付け時間
SPVS, SPVN, SPVT, SPVM, SPVR, SPVE, SPPW8, SSCQ, SSCM, SPVL, SSCT, SPVQC	350±5°C	3s max.
SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SSCN, SPVQA	300±10°C	3+1/0s
SPPB (Reflow)	300±5°C	5s max.
SSCF, SPPB (For Lead, Dip)	350±10°C	3+1/0s

ディップ式の参考例

For PC board 端子タイプに適用

シリーズ	項目		ディップはんだ	
	プリヒート温度	プリヒート時間	はんだ温度	はんだ浸漬時間
SSCT, SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SPVQA	100±10°C	60s max.	260±5°C	5±1s
SPPW8, SPPB	100 °C max.	60s max.	255±5°C	5±1s
SSCF	—		260±5°C	5±1s